

PALTEK

(証券コード:7587)

2020年12月期 第1四半期 決算説明資料

2020.5.8 (金)

© 2020 PALTEK Corporation. All rights reserved.

本資料取り扱い上の注意点

本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき判断したもので、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

なお、本資料においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。

また、実際の業績に影響を与えうるリスクや不確実な要素には、以下のようなものが含まれます。

- ① 国内エレクトロニクス業界の急激な景気変動や需要動向の変化
- ② 仕入先の代理店政策の見直しや再編等により取引関係の継続が困難となった場合
- ③ 不測の事態による当社グループの情報資産が流出した場合
- ④ 為替相場の急激な変動
- ⑤ 新規仕入先商品の立ち上がりの遅れが生じた場合
- ⑥ 顧客の日本国内での製品開発案件が更に海外へシフトし、当社グループの販売活動が及ばない地域へ移管された場合

- ① **2020年12月期 第1四半期
業績結果**
- ② **2020年12月期 業績予想**
- ③ **今後に向けた取り組み**

- ① **2020年12月期 第1四半期
業績結果**

(百万円)	2019年第1四半期		2020年第1四半期		増減	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
売上高	7,114	100.0%	8,756	100.0%	1,641	23.1%
売上総利益	887	12.5%	1,073	12.3%	186	21.0%
販管費	804	11.3%	861	9.8%	57	7.1%
営業利益	83	1.2%	212	2.4%	128	155.2%
経常利益	△5	△0.1%	145	1.7%	151	-
親会社株主に帰属する当期純利益	△15	△0.2%	73	0.8%	89	-
1株当たり四半期純利益	△1.45円	-	6.68円	-	8.14円	-

主な増減要因

- 売上高は、半導体事業およびデザインサービス事業が堅調なため増加
- 営業利益は、新規事業への投資などで販管費は増加するも、売上高増により増加

(百万円)	2019年第1四半期		2020年第1四半期		増減	
	金額	比率	金額	比率	増減額	増減率
半導体	6,382	89.7%	7,970	91.0%	1,588	24.9%
デザインサービス	467	6.6%	530	6.1%	63	13.5%
ソリューション	264	3.7%	255	2.9%	△9	△3.7%
売上高合計	7,114	100.0%	8,756	100.0%	1,641	23.1%

主な増減要因

- 半導体事業は、通信機器・放送機器・計測機器向けFPGA、海外の携帯情報端末向けのメモリ製品などが堅調に推移したため増加
- デザインサービス事業は、通信機器、医療機器向けなどが増加
- ソリューション事業は、映像配信システムなどが引き続き堅調に推移

■ 売上総利益率の減少は、以下の2つが要因

- ドル円相場の変動により、仕入先に対して保有する仕入値引ドル建債権の評価額は変動。

売上総利益に対する影響額は、

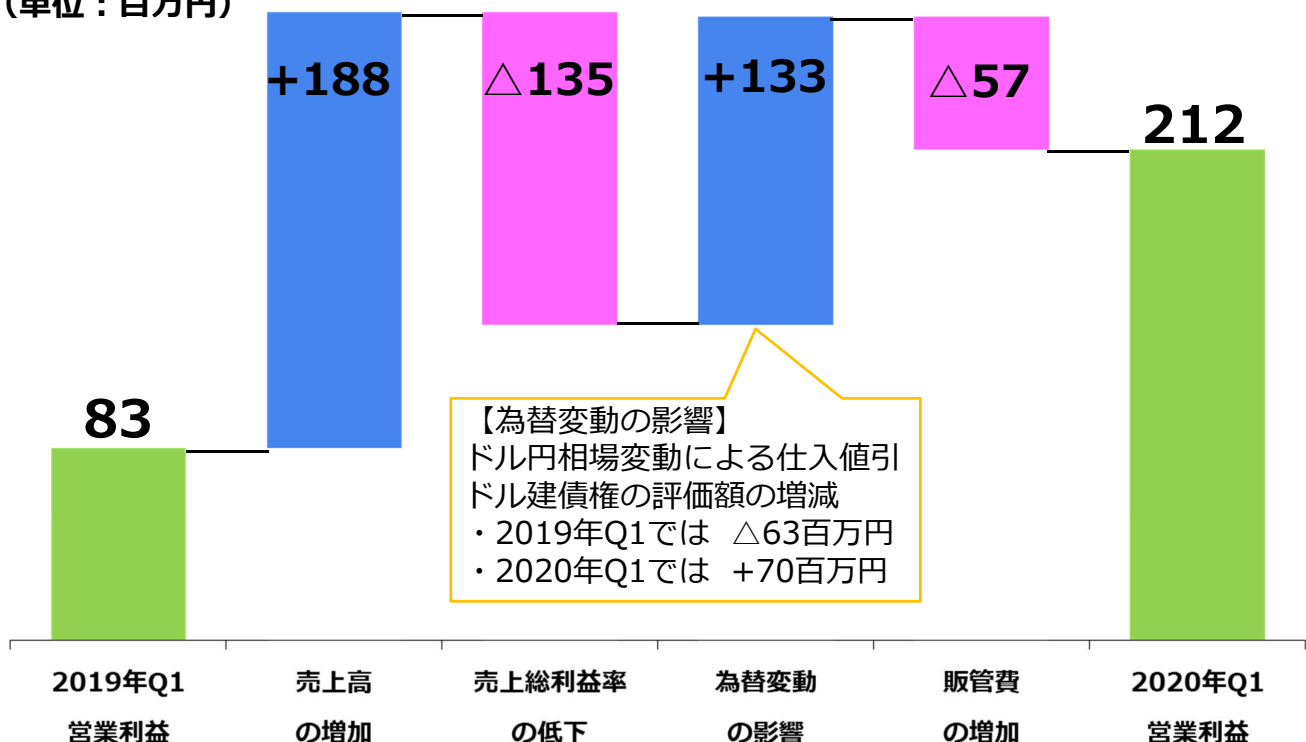
2019年第1四半期では △63百万円 (△0.9%分)

2020年第1四半期では +70百万円 (+0.8%分)

(百万円)	2019年第1四半期		2020年第1四半期	
	金額	対売上比率	金額	対売上比率
売上総利益	887	12.5%	1,073	12.3%
(うち為替の影響額)	△63	△0.9%	+70	+0.8%
売上総利益 (為替の影響を排除)	950	13.4%	1,003	11.5%

- 半導体事業において、FPGAビジネスで主要大手顧客の売上高が増加したことにより利益率が低下

(単位：百万円)

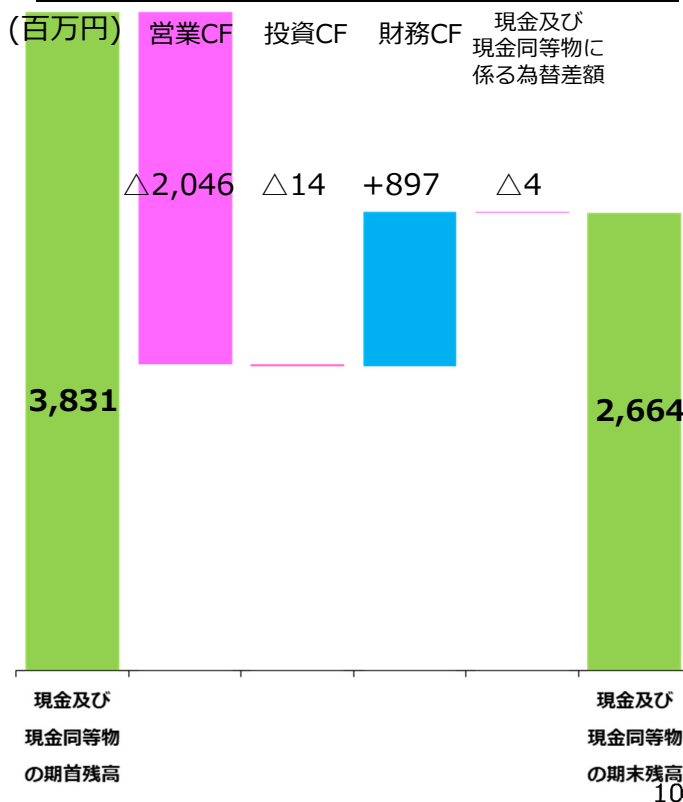


連結貸借対照表の状況

	(百万円)	2019.12	2020.03	増減額	主な増減理由
資産内訳	現金及び預金	3,831	2,664	△1,167	
	売上債権	6,589	7,908	1,319	Q1期末での売上増のため
	商品	2,915	3,079	163	
	その他流動資産	2,177	2,800	623	
	固定資産	556	602	46	
資産合計		16,069	17,055	985	
負債純資産内訳	仕入債務	863	1,395	532	
	短期借入金	3,680	4,680	1,000	仕入債務の支払いに充当するため
	その他流動負債	1,775	1,255	△519	
	固定負債	219	230	10	
	純資産	9,531	9,493	△37	
負債・純資産合計		16,069	17,055	985	

連結キャッシュ・フローの状況

2020年第1四半期のキャッシュフローの動き



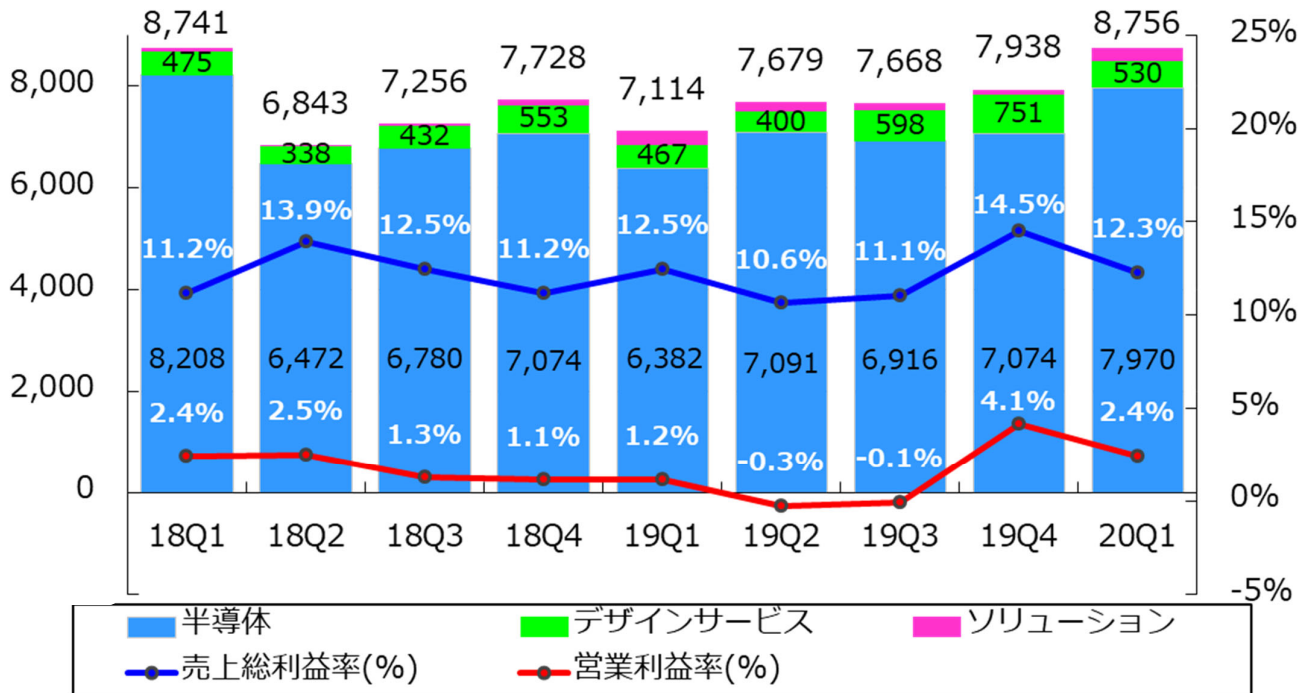
(百万円)	2019年 第1四半期	2020年 第1四半期
現金及び現金同等物の期首残高	2,024	3,831
営業CF	916	△2,046
投資CF	△4	△14
財務CF	△352	+897
現金及び現金同等物の期末残高	2,598	2,664

2020年第1四半期キャッシュフローの動き

- 【営業CF】 売上債権および未収消費税等の増加などにより支出
- 【投資CF】 有形固定資産および無形固定資産の取得などにより支出
- 【財務CF】 配当金の支払いを実施した一方で、短期借入れの実施などにより収入

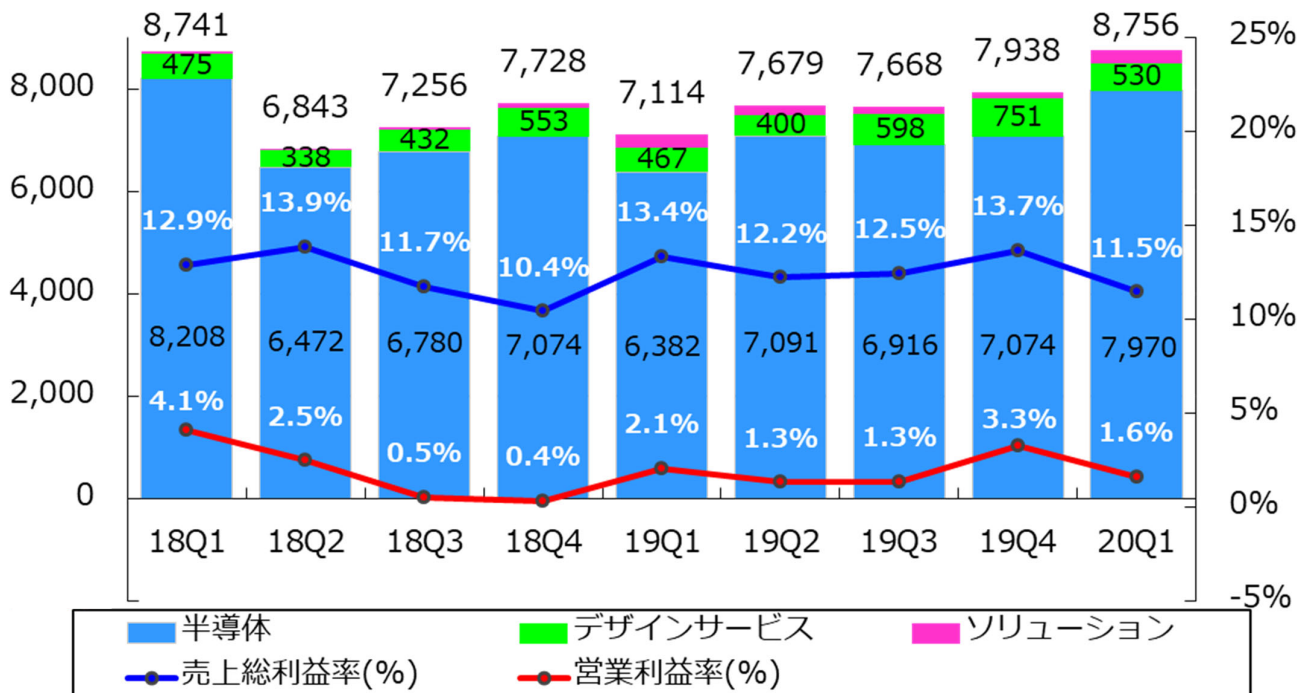
連結業績の四半期推移

(百万円)



連結業績の四半期推移 (為替の影響を除いた場合)

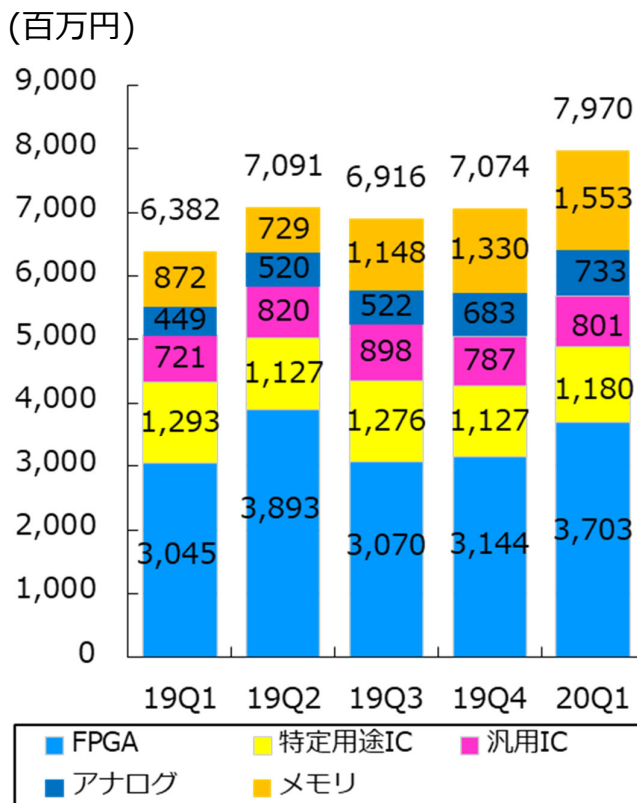
(百万円)



事業別の実績

© 2020 PALTEK Corporation. All rights reserved.

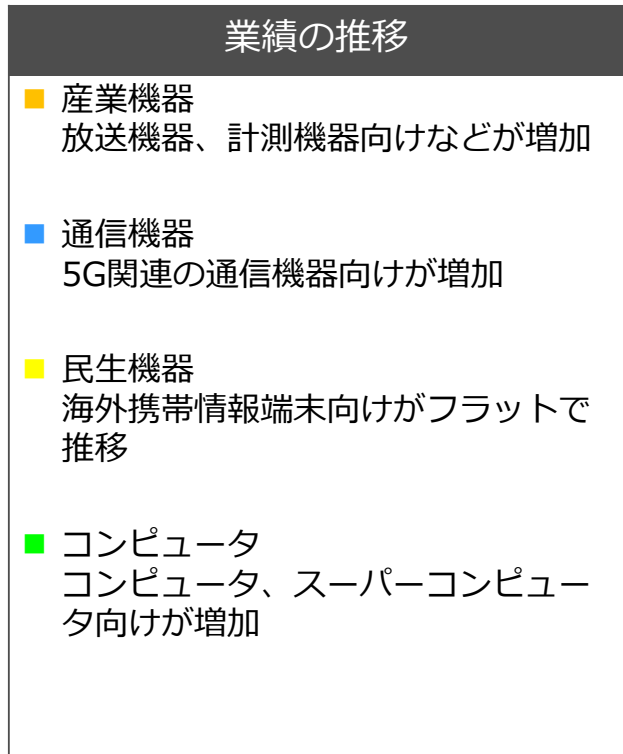
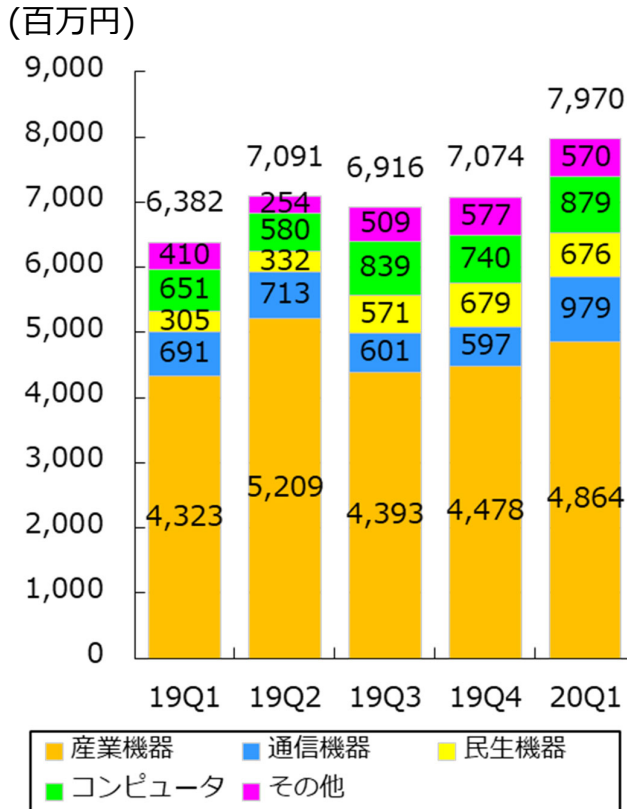
半導体事業の状況（製品別）



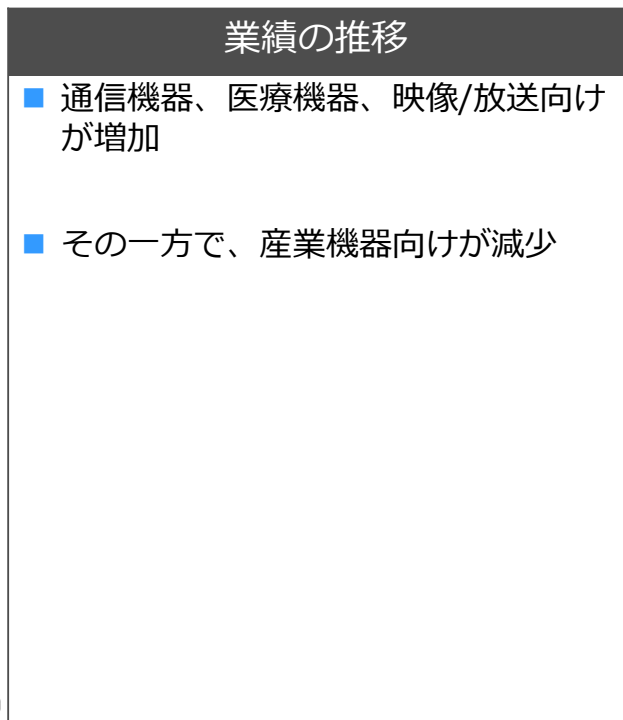
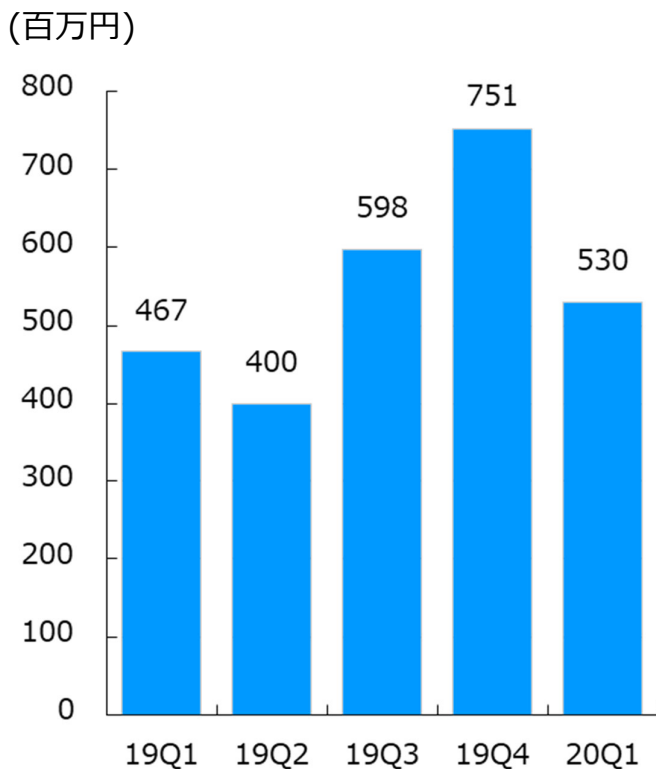
業績の推移

- F P G A
通信機器、放送機器、計測機器向け
などが増加
- 特定用途 I C
ブロードバンド向け通信機器などが
増加
- 汎用 I C
ファクトリーオートメーション向け
がフラットで推移
- アナログ
コンピュータ、スーパーコンピュー
タ向けなどが増加
- メモリ
海外ビジネス向けが堅調

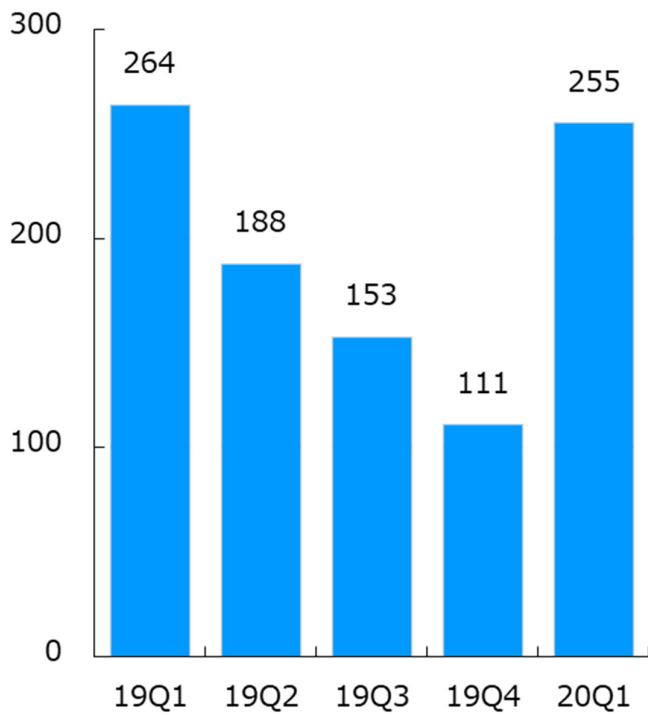
半導体事業の状況（用途別）



デザインサービス事業の状況



(百万円)



業績の推移

- 映像配信システムが航空/宇宙分野向けに増加
- 紙梱包資材向けシステムや作業支援ウェアラブルロボットが増加

2

2020年12月期 業績予想

第1四半期業績が堅調のため、第2四半期(累計)業績予想を修正

ただし、通期業績については、今後の事業状況を見通すことが困難なため、現時点で修正は行わない

■ 第1四半期業績結果の状況

- 第1四半期業績は、想定を上回って推移

■ 第2四半期(累計)の見通し

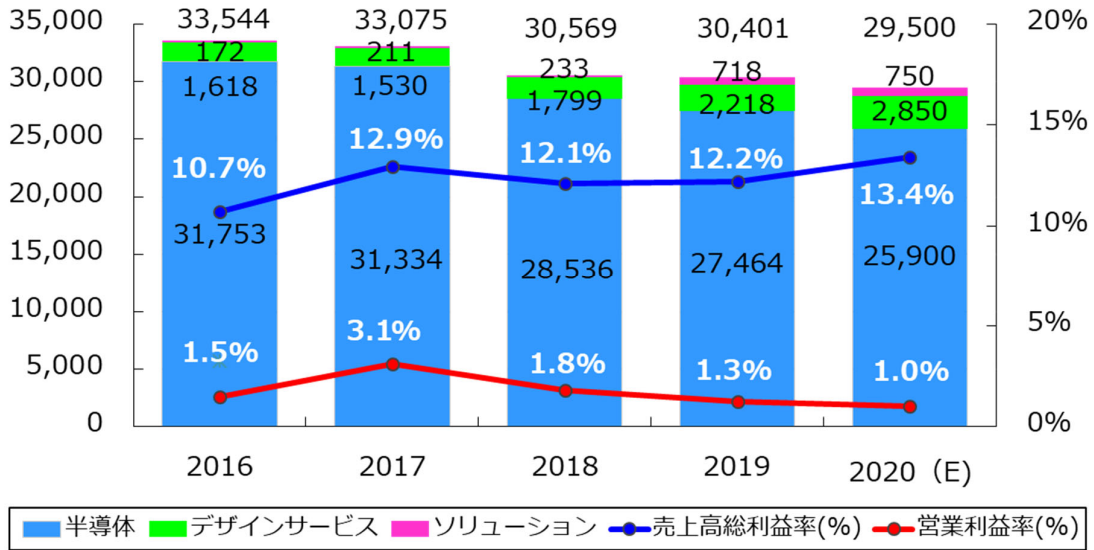
- 現時点で想定できる状況を勘案し、業績予想を修正

■ 通期の見通し

- 下期において、新型コロナウイルス感染症の影響がどれほどになるか現時点で見通すことが困難なため、現時点では通期業績予想の修正は行わない

(百万円)	2020年12月期 予想			2020年12月期 予想 (5/8修正発表)			通期増減	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	増減額	増減率
売上高	14,000	15,500	29,500	16,000	13,500	29,500	-	-
売上総利益	1,850	2,100	3,950	2,000	1,950	3,950	-	-
売上総利益率	13.2%	13.5%	13.4%	12.5%	14.4%	13.4%	-	-
販管費	1,800	1,850	3,650	1,760	1,890	3,650	-	-
営業利益	50	250	300	240	60	300	-	-
営業利益率	0.4%	1.6%	1.0%	1.5%	0.4%	1.0%	-	-
経常利益	10	210	220	150	70	220	-	-
当期純利益	7	143	150	80	70	150	-	-

(百万円)



- 売上高 : デザインサービス事業が増加するものの、半導体事業が減少
- 売上総利益率 : 利益率の高いデザインサービス事業の売上高が増加するため上昇
- 営業利益率 : モビリティビジネス、AIソリューションなどの新規事業への人材投資を継続するため販売費及び一般管理費が増加し、営業利益率は低下

■ 半導体事業での想定される影響

- ・ ファクトリーオートメーション、放送機器、計測機器向けなどの先行き不透明
- ・ 医療機器向けはフラットを想定

■ デザインサービス事業での想定される影響

- ・ 開発案件への投資が抑えられる可能性あり

■ ソリューション事業での想定される影響

- ・ 全般的に、新規顧客訪問が積極的に行えない、展示会の中止など営業活動への影響が大きく、事業の立ち上がりはスローに
- ・ 新たに取り扱い始めた空間除菌システムでの需要の掘り起こし
- ・ 紙梱包資材システムでの電子販売（EC）や脱プラ向けでの需要掘り起こし

■ 新規ビジネスへの投資は継続

3

今後に向けた取り組み

【半導体事業【基軸】】 重点施策について

【事業環境】

- 5G、IoT、ビッグデータ、AIの活用により半導体市場が拡大
 - ネットワークの高速化に伴いエッジコンピューティングなどの活用が見込まれる
- 車載分野およびその関連市場の半導体市場拡大へ



取り組み

- 5G、IoT、データセンター、エッジコンピューティング、AI使用関連市場に注力
 - ⇒ FPGA、メモリ、マイコン、電源などビジネス拡大
- ソリューション提案（新たな市場へ展開）
 - （例：エッジコンピューティング+AI..etc）

- 産業機器・通信機器などの既存市場に加え、AI/IoT、金融、ビデオ、物流分野に向けたプロモーションを強化

既存市場

- FA・ロボット
- 医療機器
- 放送機器
- 計測機器
- 通信機器



FPGAの新規市場

【AI/IoT】
農業、工場、小売、建機



【金融】
銀行、証券会社



【ビデオ】
動画配信、OTT、防衛

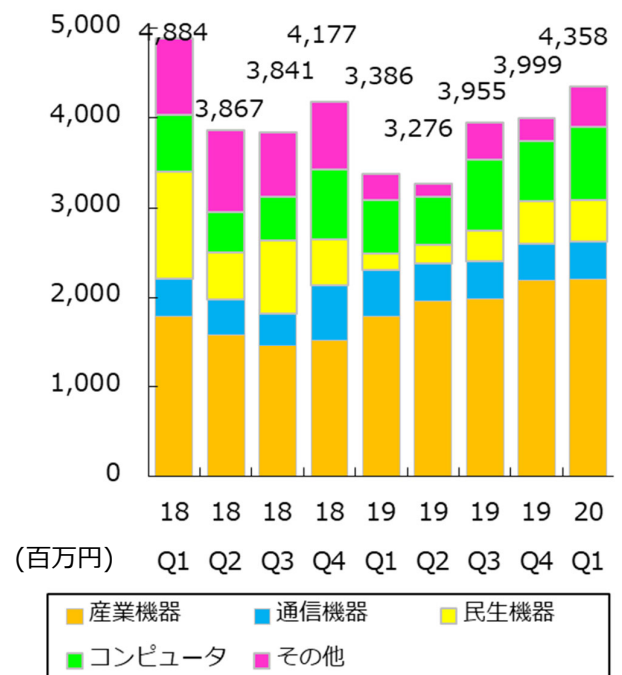


【物流】
通信販売、食品/製薬
観光業、バス/トラック



- 産業機器向けはゆるやかに増加傾向
- 成長市場へ新規案件活動継続
 - 5G
 - IoT/データセンター/クラウド
 - 産業機器

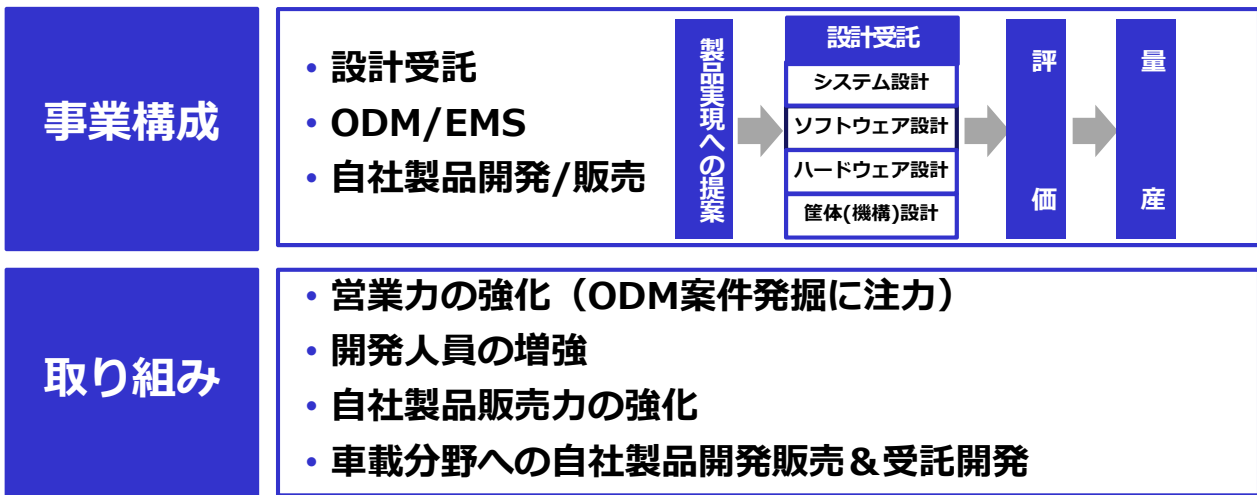
売上高の推移



【デザインサービス事業 [基軸] ・ [新規] 】 重点施策について

【事業環境】

- ・ 機器自体やそれを構成する半導体などが高機能化・高度化し、すべてをお客様のみで開発することが困難
- ・ お客様は社外リソースも活用し、製品リリースの早期化が必要



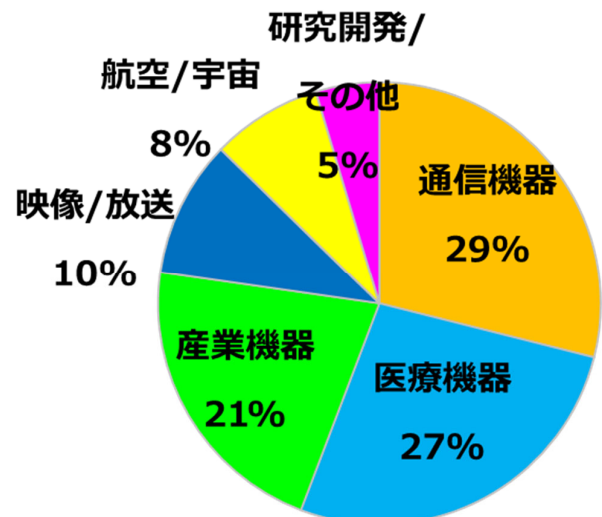
設計受託およびODMの状況

■ 事業の状況

- ・ 公共インフラ向け（産業機器）のODMは減少するも通信機器、医療機器が堅調

■ ODMの比率は約50%

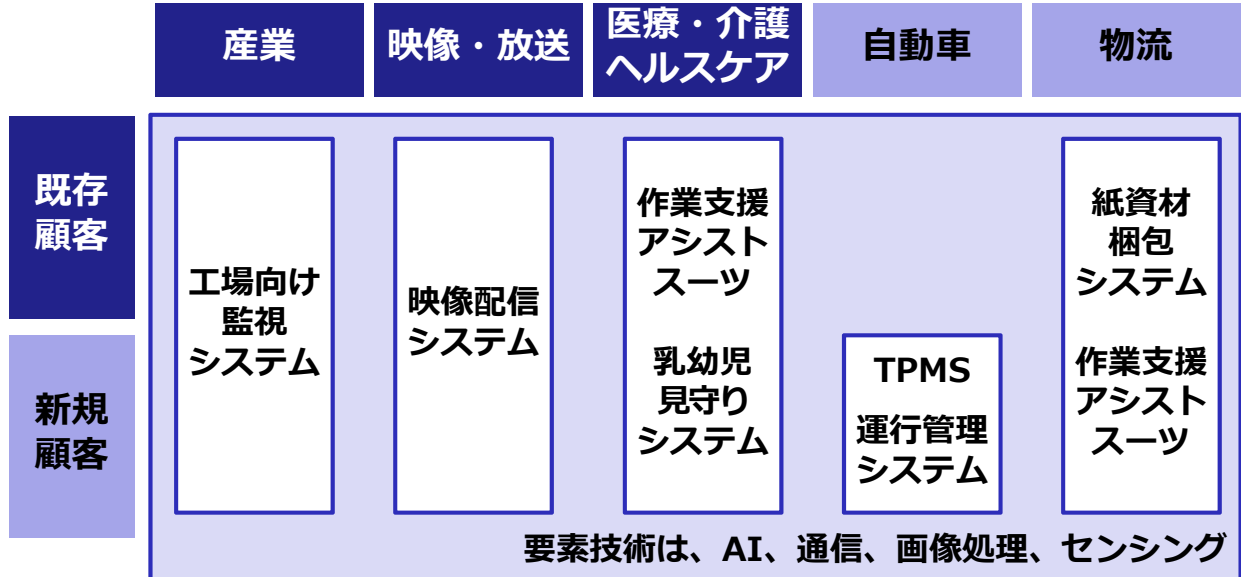
用途別売上構成（2020年Q1）



【ソリューション事業 [新規]】 事業領域の開拓

■ ソリューション事業の狙い

- 市場拡大が見込まれる分野に注力したソリューションを発掘・開発
- 将来的にIoTやサービス等の付加価値の可能性のあるソリューションを展開



紙資材梱包システムのビジネス進捗

■ ビジネスの位置づけ

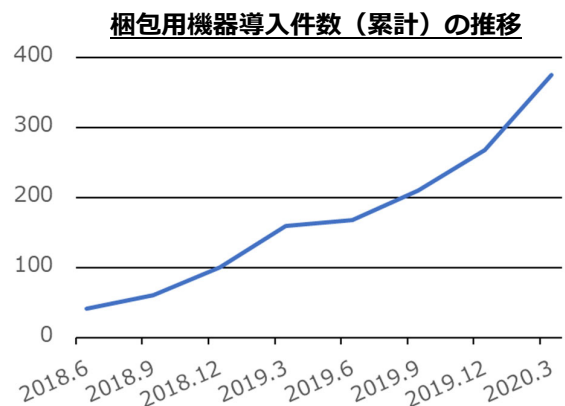
- 成長すると見込まれる物流分野への事業展開
- 生態系への影響懸念により脱プラスチックが進む中、プラスチック系緩衝材に代わる紙緩衝材活用を提案
- ストック型ビジネス



<梱包用機器>

■ システム導入件数は順調に増加

■ 展示会等へ出展できないため、 既存案件フォローおよび WEBを活用したプロモーション



■ ビジネスの位置づけ

- 保育施設や介護施設向けに、乳幼児や高齢者などの感染症予防として空気中の細菌やウイルスの不活性化が可能な空間除菌システムの取り扱いを開始
- 保育施設や介護施設以外に、店舗や商業施設、オフィスなどへも提供開始

■ 空間除菌システム

- 業務用空間除菌デバイス「Devirus AC」
 - 空間除菌剤である亜塩素酸水を微細なミストにして空間噴霧し、浮遊するウイルスや細菌・カビなどを不活性化
- 亜塩素酸水「クロラス除菌ウォーター」
 - 「亜塩素酸水」は次亜塩素酸ナトリウムの10倍以上の抗ウイルス効果がありながら、低腐食、低臭気、低刺激で、食品添加物としても厚生労働省から認められている液体

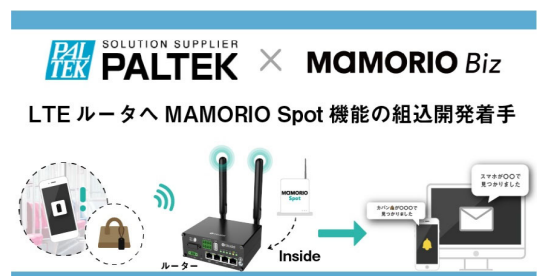


■ ビジネスの位置づけ

- MAMORIOとアライアンス契約を締結し、IoTビジネスを拡大
- 企業や組織単位で所有する物品の紛失リスクの低減
- 急増するテレワーク時の紛失対策のひとつとして、MAMORIO Bizの活用推進

■ アライアンス契約によるビジネス拡大

- IoTを活用した法人向け紛失防止サービス「MAMORIO Biz」の提供
- LTEルータへの「MAMORIO Spot」機能の組込開発
 - 紛失防止サービスへの更なる付加価値の創出





かながわSDGsパートナーズへの登録

- 当社が取り組む事業がSDGs実現に向けた取り組みであると認められ、「かながわSDGsパートナー」に登録されました
- 「かながわSDGsパートナー」とは
 - ・ 神奈川県と持続可能な開発目標（SDGs）への実現に向けた取り組みを行う企業・団体等が連携し、またパートナー間の連携を県が後押しすることで、県内のSDGsに関する企業・団体等の取り組みを促進させる制度
- 今後、神奈川県やかながわSDGsパートナーと連携し、SDGsの実現に向けた取り組みを推進してまいります



KANAGAWA SDGs PARTNER

神奈川県 | SDGs未来都市 私たち一人ひとりの行動が、未来につながる。



SOLUTION SUPPLIER
PALTEK

参 考 資 料

為替変動に関する影響

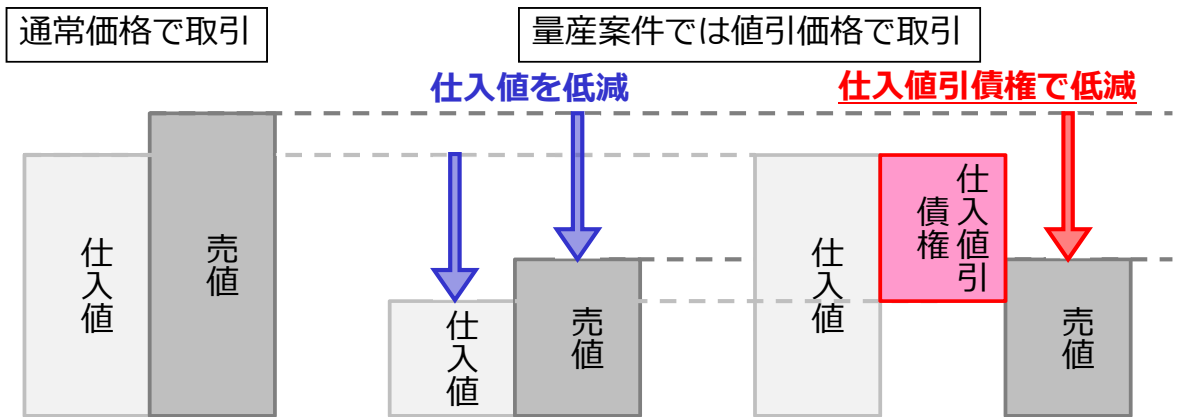
為替変動による影響について

- 為替変動により当社グループの利益は以下の4点で影響を受ける
 - ① 仕入値引ドル建債権の為替変動による影響
 - ② 調達在庫の為替変動による影響
 - ③ 決済時のドル調達レート変動による影響
 - ④ ドル建売掛金入金時のレート変動による影響

為替変動による影響の発生要因①

【仕入値引ドル建債権の為替変動による影響】

- 当社が仕入先に対して保有する『仕入値引ドル建債権』が、為替レートの変動により評価額が増減することで、業績に大きな影響を与える
- 仕入値引ドル建債権について：
 - ・ 量産案件によっては、通常価格よりも低い価格での販売を要請されることがある
 - ・ その場合、仕入先との間で仕入価格の低減交渉を行う
 - ・ その実現方法は、「仕入値自体の低減」と「仕入値引債権の付与による低減」



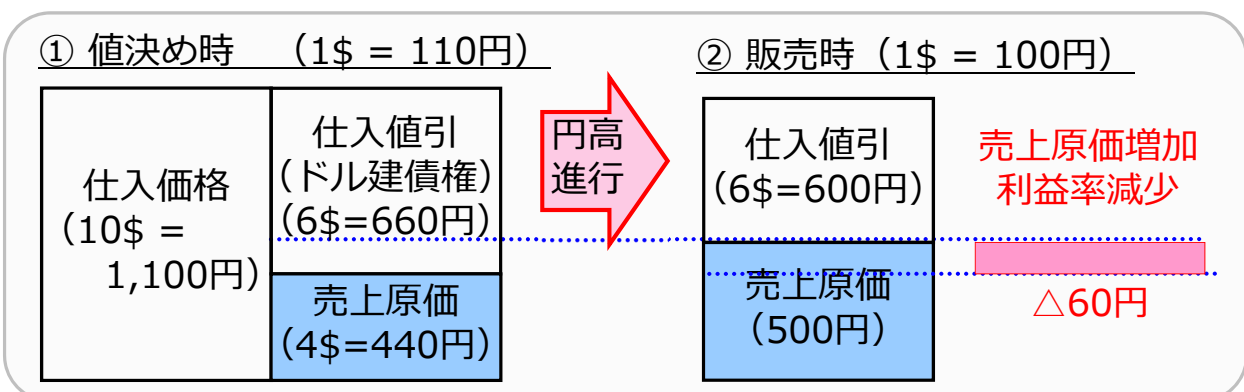
37

© 2020 PALTEK Corporation. All rights reserved.

急速な円高進行による仕入値引債権の評価額減少

- 仕入値引債権の評価額の増減は、値決め時と販売時の為替レートの差により生じる
- そのため、急速に円高が進行すると、為替レートの差が大きくなるため、仕入値引債権の評価額が大幅に減少
- これにより、売上原価が増加し、売上総利益が減少

例：仕入れ価格10ドルの製品を販売する際の売上原価の変化



38

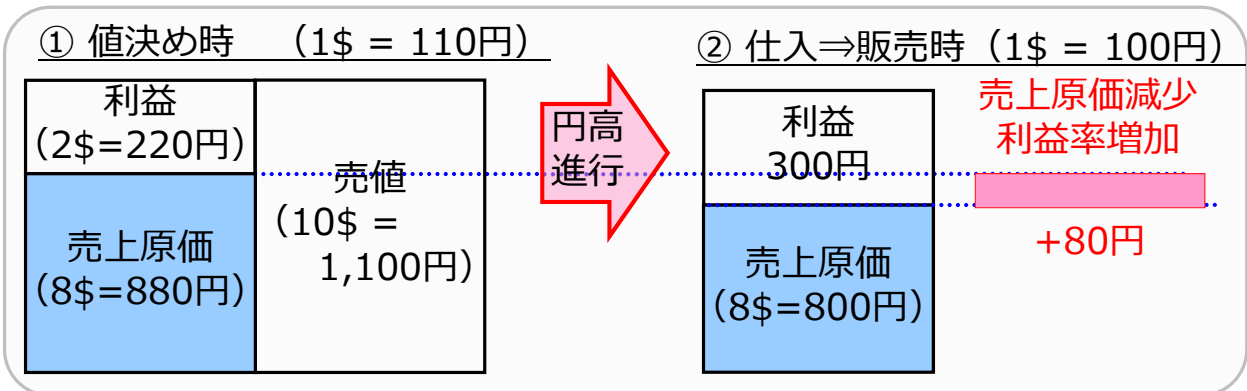
© 2020 PALTEK Corporation. All rights reserved.

為替変動による影響の発生要因②

【調達在庫の為替変動による影響】

- 海外から仕入れたドル建の製品において、為替レートが円高に進行することにより、売上原価が減少し、売上総利益は増加

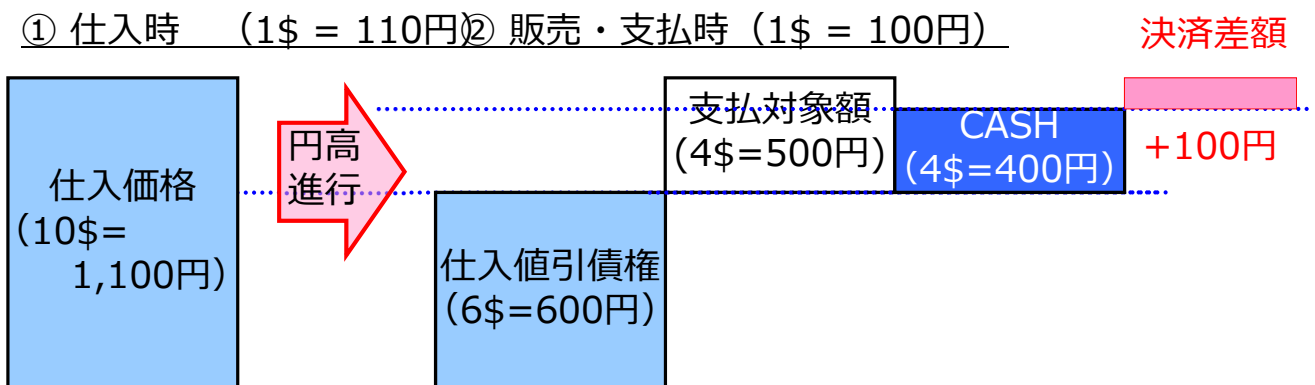
例：仕入れ価格10ドルの製品を販売する際の売上原価の変化



為替変動による影響の発生要因③

【決済時のドル調達レート変動による影響】

- 支払を行う際に円高に進行していた場合、ドルを調達する金額が少なくなるため、決済差額が生まれ、為替差益を計上することとなる
- 一方、円安に進行した場合は、為替差損を計上することとなる

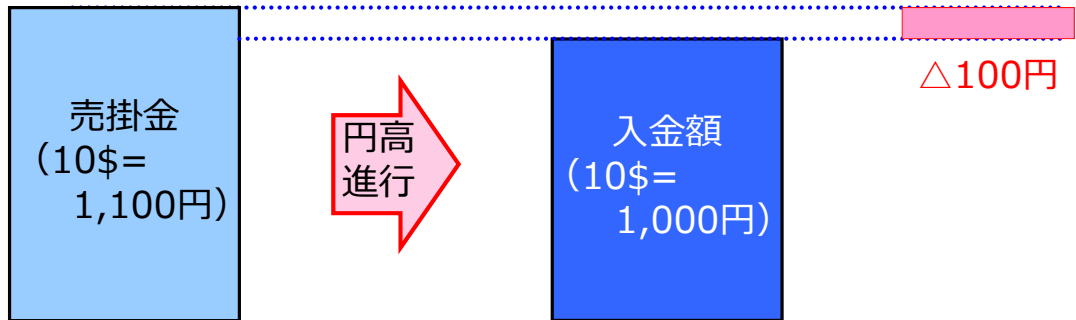


【ドル建売掛金入金時のレート変動による影響】

- ドル建売掛金のお入金がある場合には、円高に進行するとマイナス、円安に進行するとプラスの影響が発生する（営業外の為替差損益）
- 当社はこのリスクを限定的にするために、為替予約を行っている

① 販売時 (1\$ = 110円)

② 入金時 (1\$ = 100円) 決済差額



■ 売上総利益への影響額

- Q4の評価レートからQ1における評価レートは期中では乱高下したが、月末レートは過去よりも円安方向で推移したため為替変動の影響額はプラス方向に

(単位：百万円)	19Q1	19Q2	19Q3	19Q4	20Q1
為替レートの変動 (円)	108→110	110→(112) →107	108→(106) →108	108→(109) →108	108→(112) →101→ 111)→108
為替変動の影響 (売上総利益)	-63	-124	-108	69	70
仕入値引債権の評価額変動の影響	-396	60	-542	241	198
調達在庫の為替レート変動の影響	333	-183	434	-172	-127

■ 営業外損益への影響額 (期末評価替の影響は含まず)

- 買掛金支払時のレート変動の影響は△26百万円

(単位：百万円)	19Q1	19Q2	19Q3	19Q4	20Q1
買掛金支払時のレート変動の影響 (営業外)	-15	122	64	-98	-26

- 売掛金受取時のレート変動の影響額は△20百万円

(単位：百万円)	19Q1	19Q2	19Q3	19Q4	20Q1
売掛金受取時のレート変動の影響 (営業外)	-42	-49	-61	-3	-20

(百万円)	2019年12月期 実績			2020年12月期 業績予想			通期増減	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	増減額	増減率
半導体	13,473	13,991	27,464	14,500	11,400	25,900	△1,564	△5.7%
FPGA	6,938	6,215	13,154	7,000	4,000	11,000	△2,154	△16.4%
特定用途IC	2,421	2,404	4,825	1,900	2,100	4,000	△825	△17.1%
汎用IC	1,542	1,686	3,228	1,550	1,650	3,200	△28	△0.9%
アナログ	969	1,206	2,175	1,350	1,250	2,600	424	19.5%
メモリ	1,601	2,479	4,081	2,700	2,400	5,100	1,018	25.0%
デザインサービス	867	1,350	2,218	1,100	1,750	2,850	631	28.5%
ソリューション	453	265	718	400	350	750	31	4.3%
売上高合計	14,794	15,607	30,401	16,000	13,500	29,500	△901	△3.0%
営業利益	61	322	384	240	60	300	△84	△21.9%

開示区分	内容説明
半導体事業	半導体及び関連製品の販売、技術支援
FPGA	ザイリンクス社のFPGAを中心とするソリューション
特定用途IC	特定用途に特化した半導体を中心とするソリューション (例：通信向け、インタフェース向け、携帯端末向け等)
汎用IC	NXPセミコンダクターズ社、マイクロチップテクノロジー社等の汎用ICを中心とするソリューション
アナログ	アナログ半導体を中心とするソリューション
メモリ	マイクロンテクノロジー社等のメモリを中心とするソリューション
デザインサービス事業	受託開発、ODM/EMS/OEM
ソリューション事業	最終製品レベルでのソリューション提案を実施 自社製品（ハードウェア、ソフトウェア、システム）の 開発・販売



以下の担当までお問い合わせ下さい。

株式会社PALTEK

柴崎 由記 (IR担当)

〒222-0033

横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエアビル

TEL : 045-477-2072

FAX : 045-477-2012

E-mail : ir@paltek.co.jp